

技術と対話で未来をつくる Technology & Tai-wa for Tomorrow

このたび、2025年4月1日付で代表取締役 社長執行役員に就任いたしました。1986年に、当時の国際電気株式会社に入社して以来、半導体製造装置事業に従事してまいりました。これまでの製造や営業、経営企画、海外駐在の経験を生かしながら、上場会社としての社会的責任をより一層強く自覚し、事業活動とESG(環境・社会課題の解決、ガバナンスの強化)の取り組みの両側面から、企業価値向上に向けたイノベーションの創出に取り組んでいく所存です。引き続き皆様のご理解、ご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

当社グループは、1950年代に半導体製造装置の開発に着手し、約70年にわたって半導体デバイス製造の前工程における成膜に特化した研究開発に取り組んできました。2018年に株式会社KOKUSAI ELECTRICとして独立し、2023年10月に東京証券取引所プライム市場に上場した現在に至るまで、世界中の半導体デバイスメーカーの多様なニーズにお応えしてきました。

当社グループを取り巻く半導体デバイス市場は、スマートフォンやパソコンなどのコンシューマー向けの需要拡大に加え、データセンターや5G、生成AI、環境負荷低減への投資(GX)などの産業向けの需要拡大、主要国の産業支援策により、今後も大きく成長することが予想されています。また、半導体デバイスの進化に伴って、その構造は複雑化、三次元化、微細化へのシフトが進んでいることから、より高性能な半導体製造装置が求められるようになり、半導体製造装置市場もまた大きく成長することが見込まれています。このような市場環境の中で、当社が業界トップクラスの市場シェアを有するバッチALD*対応成膜装置と枚葉トリートメ

ント装置を生かせる機会が増加していくため、当社はWFE (Wafer Fab Equipment: 半導体製造装置市場) 成長を上回る売上成長をめざしてまいります。

加速する半導体デバイスの高密度化や高性能化に応える半導体製造装置を世の中に提供していくことは、半導体デバイスの進化を支える私たちの使命です。これからもコーポレートスローガン“技術と対話で未来をつくる (Technology & Tai-wa for Tomorrow)”のもと、創造と革新が生まれる未来を支えてまいります。

※当社グループでは、複数のガスをサイクリックに供給する工程を伴い、原子層レベルで成膜する手法を「ALD」と呼んでいます。

代表取締役 社長執行役員

塚田 和徳



生年月日：1965年12月6日
出身地：長野県長野市
座右の銘：蒔かれたところで育つ
趣味：靴磨き、散歩、カメラ

足元の業績と今後の見通し

2025年3月期連結決算ハイライト

- 生成AIの普及を背景に先端DRAM向け設備投資が活発。Logic/Foundry向け設備投資は成熟ノード向けに落ち着きが見られるものの、先端ノード向けが増加。NAND向け設備投資に回復の兆し。
- 当社25/3期は、全てのアプリケーション向けで装置販売が伸長し、サービスビジネスも伸長したことから、前期比で増収増益。

2026年3月期連結業績予想ハイライト

- 先端DRAM、先端ノードLogic/Foundryに対する積極的な設備投資に続いて、NAND向けで設備投資が進む見通し。
- 当社では、先端デバイス向けを中心に世界各国向け売上が増加、中国市場売上は減少し、中国市場売上比率は平常化。米中貿易摩擦や各国関税政策による間接的な影響を想定し、業績予想は慎重な見方で策定。

配当金実績および配当予想

2025年3月期の連結業績を踏まえ、当期末配当を当初予想18円に1円増配し、1株当たり19円としました。これにより、1株当たりの年間配当金は中間配当金18円と合わせて37円となりました。

配当金実績および配当予想

2025年3月期		
1株当たり 中間配当	1株当たり 期末配当	合計
18円	19円	37円

2026年3月期（予想）		
1株当たり 中間配当	1株当たり 期末配当	合計
18円	18円	36円

中長期戦略

当社グループは、WFE (Wafer Fab Equipment: 半導体製造装置市場) の市場規模および市場成長を前提として、以下の中期目標を設定しています。

また、資本コストを意識しながら中長期的な視点で資本収益性を向上させるため、WACC (Weighted Average Cost of Capital: 加重平均資本コスト) を上回るROIC (Return on Invested Capital: 投下資本利益率) およびROE (Return on Equity: 自己資本利益率) の目標を設定しています。

	24/3 期実績	25/3 期実績	26/3 期予想	中期目標
売上収益	1,808 億円	2,389 億円	2,440 億円	3,300 億円以上
装置ビジネス売上比率	65%	69%	70%	75%程度
サービスビジネス売上比率	35%	31%	30%	25%程度
調整後営業利益率 ^{*1}	20.9%	24.2%	22.6%	30%以上
研究開発費（対売上収益比率）	7.0%	6.5%	—	6%程度
（参考）ROE（自己資本利益率）	15.7%	22.1%	—	25%以上
（参考）ROIC（投下資本利益率）	10.1%	15.8%	—	23%以上
（参考）前提とした WFE 市場規模	1,000 億ドル (2023年) ^{*2}	—	—	1,200 億ドル以上

※1: 調整後営業利益は以下の算式により算出しております。

調整後営業利益 = 営業利益 (IFRS) - その他の収益 + その他の費用 + 企業結合により識別した無形資産等の償却 + スタンドアローン関連費用 + マネジメントフィー + 株式報酬費用 (業績連動型株式報酬制度に係るものを除く)

※2: 当社グループ推定

株主還元方針

- 研究開発投資・設備投資の強化を最優先に、将来の事業展開のために必要な内部留保を確保しつつ、株主の皆様に対する安定的・継続的かつ積極的な利益還元を経営の重要課題と考え、連結配当性向20%から30%程度を目安に剰余金の配当を行っていくことを予定しています。
- ネットキャッシュ^{*1}がプラスに転換した後は、さらなる株主利益と資本効率の向上に向け、有利子負債分割償還後フリー・キャッシュ・フロー^{*2}の70%程度に相当する金額を配当および自己株式取得に充当することをめざします。
- 自己株式については、保有する株式数の上限を設定し、上限を超過した株式は消却することを基本としております。

※1: ネットキャッシュ = 現金及び現金同等物 - 有利子負債

※2: 有利子負債分割償還後フリー・キャッシュ・フロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー + 投資活動によるキャッシュ・フロー - 有利子負債の分割償還額

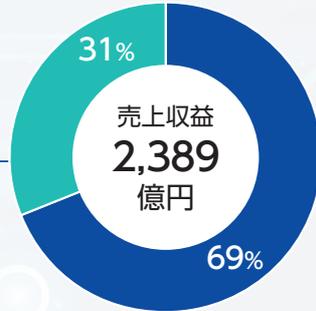
当社グループの事業

事業内容

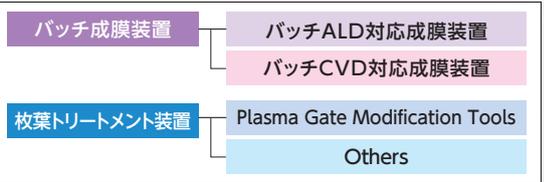
当社グループは、「成膜」に特化した企業であり、装置ビジネスでは世界トップクラスのマーケットシェアを有するバッチALD^{※1}対応成膜装置や枚葉トリートメント（膜質改善）装置が主力製品です。

サービスビジネスは、部品販売や保守サービスのリカーリングなビジネスに加えて、装置の移設・改造、ウェーハサイズ200mm以下の装置販売を手掛けています。

2025年3月期 売上収益構成比



■ 装置ビジネス



■ サービスビジネス

装置ビジネス

バッチ成膜装置

バッチALD^{※1} 対応 成膜装置

世界シェア No.1 (2024年)^{※2}

- 数十枚以上のウェーハを一括処理するバッチ成膜装置のうちALD^{※1}技術に対応する装置で、高難易度成膜と高生産性の両立が可能。
- デバイスの複雑化に伴ってニーズが拡大。



バッチCVD 対応成膜装置 バッチ酸化対応 成膜装置

- 数十枚以上のウェーハを一括処理するバッチ成膜装置のうちCVD技術や酸化技術に対応する装置。高生産性が特徴。
- CVD: Chemical Vapor Depositionの略。ガスを同時に供給し、気相で化学反応を起こして成膜する手法。当社グループではLP-CVD: Low Pressure CVDに集中。

トリートメント装置

Plasma Gate Modification Tools

世界シェアNo.1 (2024年)^{※3}

- 成膜後にプラズマや加熱により膜質を改善させることを目的とした装置で、独自のプラズマ技術により優れた等方性とステップカバレッジを実現可能。
- デバイスの複雑化に伴ってニーズが拡大。
- 低温環境における膜質改善のニーズが拡大。



サービスビジネス

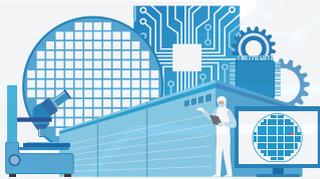
- 当社が製造・販売する半導体製造装置のライフサイクル全般にわたって、部品販売、保守サービス、有償修理、装置の移設・改造のアフターサービスを提供。
- グループ会社の販売ネットワークを活用してウェーハサイズ200mm以下のレガシー装置（新品・中古）販売にも注力。
- “Design for Service Business”のコンセプトでさらなる高付加価値サービスの提供をめざす。



※1: 当社グループでは、複数のガスをサイクリックに供給する工程を伴い、原子層レベルで成膜する手法を「ALD」と呼んでいます。

※2: 出典: TechInsights Inc. “TI_ALD Tools_YEARLY” (April 2025)

※3: 出典: Gartner®, Market Share: Semiconductor Wafer Fab Equipment, Worldwide, 2024, Bob Johnson et al, Published 21 April 2025, Revenue from Shipments basis. GARTNERは、Gartner Inc.または関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークであり、同社の許可に基づいて使用しています。All rights reserved. Gartnerは、Gartnerリサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようにテクノロジーユーザーに助言するものではありません。Gartnerリサーチの発行物は、Gartnerリサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。Gartnerは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の責任を負うものではありません。本書に記載するGartnerのコンテンツ（以下「Gartnerコンテンツ」）は、Gartnerシンジケート・サブスクリプション・サービスの一部としてGartner, Inc.（以下「Gartner」）が発行したりサーチ・オピニオンまたは見解を表すものであり、事実を述べているものではありません。Gartnerコンテンツの内容はいずれも、そのコンテンツが発行された当時の内容であり、本書が発行された日の内容ではありません。また、Gartnerコンテンツに記載されている見解は予告なく変更されることがあります。



当社グループの技術は、暮らしの さまざまな場面で活躍しています

半導体とは

物質には、金属のように電気を通す「**導体**」と、ガラスやゴムのように電気を通さない「**絶縁体**」があります。この2つの中間の性質を持った物質を「**半導体**」といい、トランジスタやダイオード、IC(集積回路)のように半導体を用いたデバイスのことを「**半導体デバイス**」といいます(慣用的に「**半導体**」とする場合もあります)。

半導体デバイスは、一定の条件により電気の通しやすさが変わるといふ半導体の特徴を生かして、電気の流れる向きや大きさを自由に制御することができます。



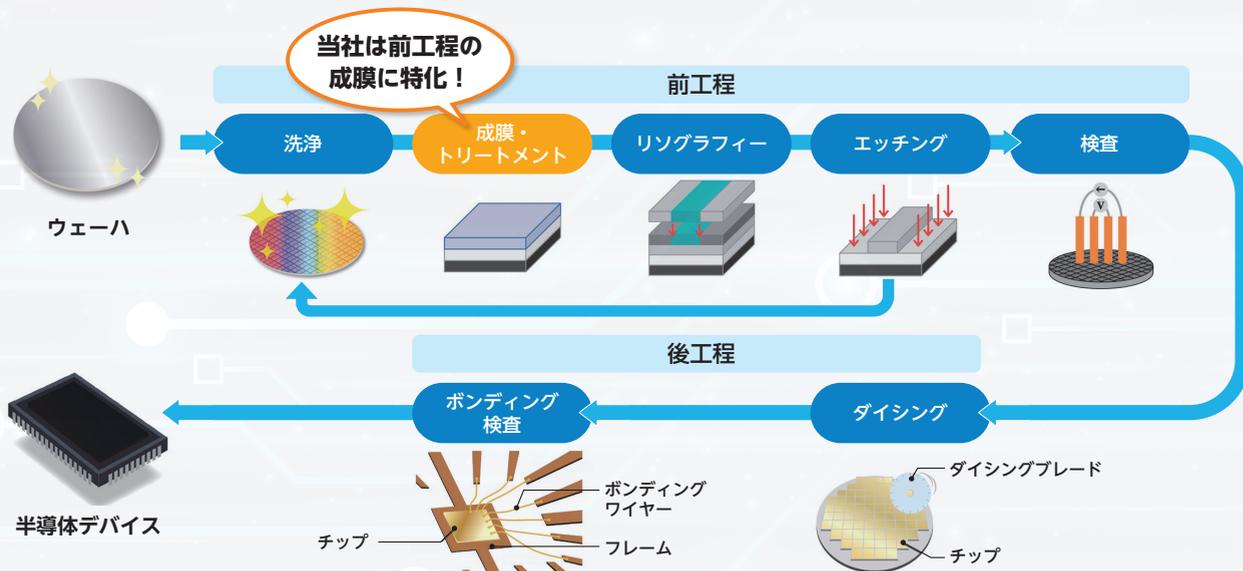
半導体はさまざまな製品に使用されています



半導体デバイス製造工程

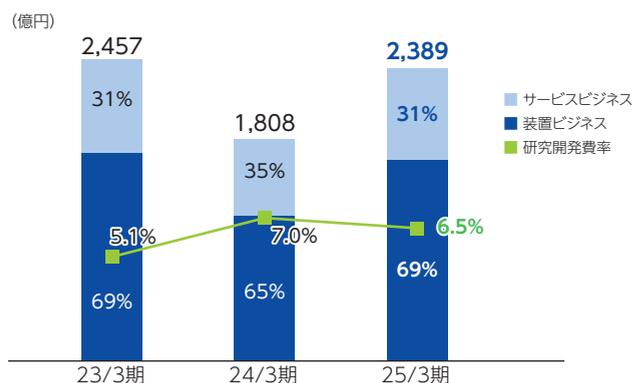
当社グループは半導体デバイスの製造工程における「前工程」の中で、デバイスの性能を左右する成膜プロセス装置と枚葉トリートメント(膜質改善)プロセス装置を開発しています。

成膜プロセスは、ウェーハに回路の素材となる薄膜などを形成する工程です。トリートメントプロセスでは、成膜プロセスで形成した薄膜の膜質を改善させる工程です。今後さらにデバイスの複雑化・微細化・三次元化が進むことで、当社グループの成膜技術やトリートメント技術がますます必要になります。

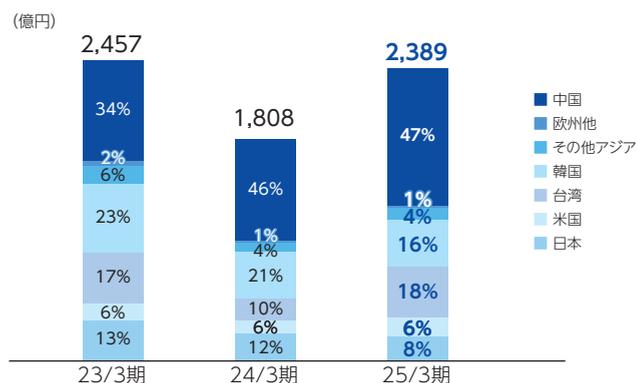


財務ハイライト (連結)

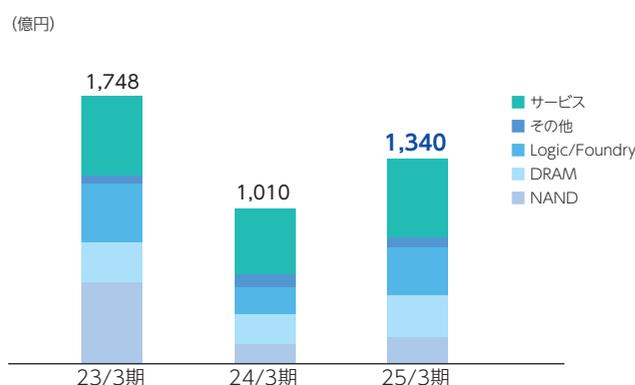
■ 売上収益(ビジネス別) / 研究開発費率



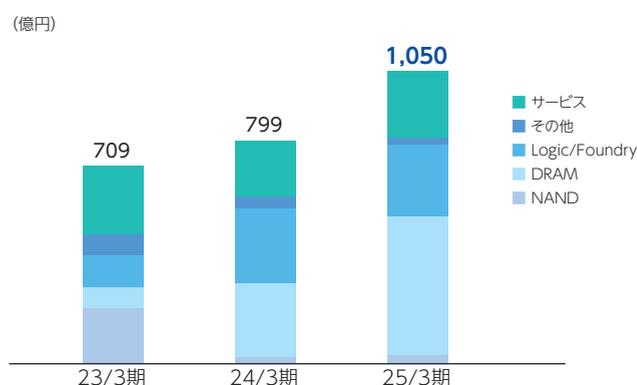
■ 売上収益(仕向地別)



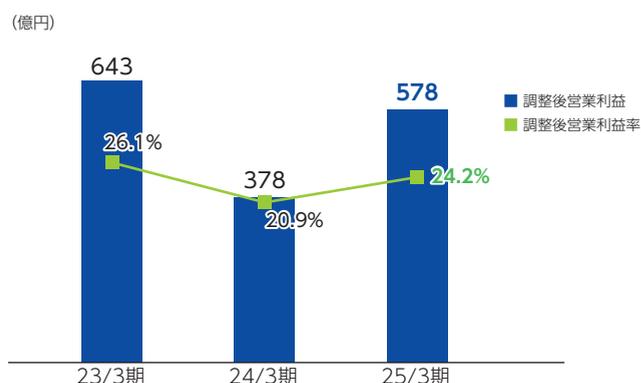
■ 世界各国向け売上収益



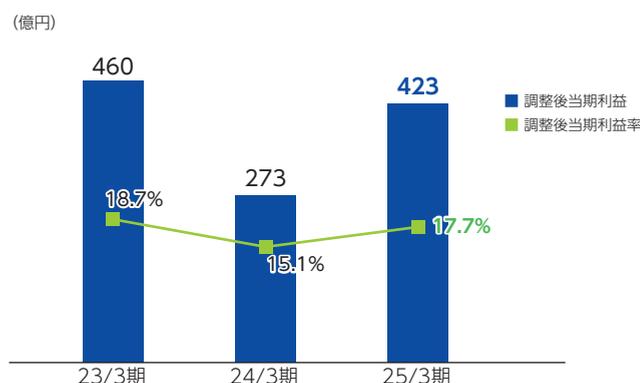
■ 中国市場向け売上収益



■ 調整後営業利益 / 調整後営業利益率



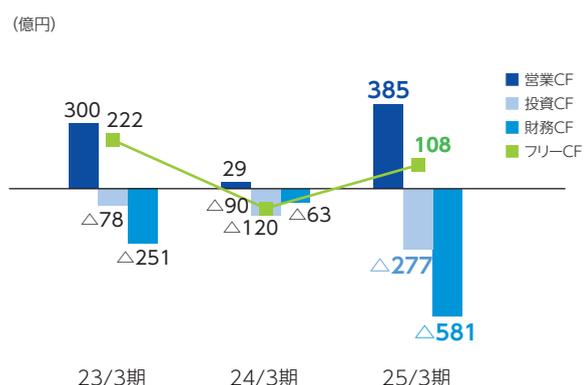
■ 調整後当期利益 / 調整後当期利益率



■ 資産合計 / 資本合計 / 自己資本比率



■ キャッシュ・フロー



会社概要・株式情報

会社概要 (2025年3月31日現在)

社名 株式会社 KOKUSAI ELECTRIC
設立 2017年2月2日
資本金 140億86百万円
従業員数 連結:2,540人/単体:1,148人
上場証券取引所 東京証券取引所プライム市場
証券コード 6525

沿革

- 1949 国際電気(株)創業
- 2000 国際電気(株)/日立電子(株)/八木アンテナ(株)が合併、(株)日立国際電気に商号変更
- 2017 公開買い付けにより、KKRグループが(株)日立国際電気の株主となる
- 2018 会社分割により(株)日立国際電気の成膜プロセスソリューション事業を承継、株式会社KOKUSAI ELECTRICに商号変更
- 2023 東証プライム市場に上場

取締役

(2025年4月1日現在)

代表取締役 塚田 和徳
業務執行取締役 柳川 秀宏
取締役 金井 史幸
取締役 小川 雲龍
取締役 中村 正樹
社外取締役 酒井 紀子
社外取締役 鶴田 雅明
社外取締役 関根 千津
取締役(常勤監査等委員) 神谷 勇二
社外取締役(監査等委員) 熊谷 均
社外取締役(監査等委員) 中田 裕人

執行役員

(2025年4月1日現在)

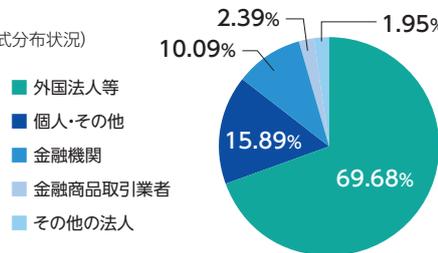
社長執行役員 塚田 和徳
専務執行役員 柳川 秀宏
常務執行役員 山田 正行
常務執行役員 河上 好隆
常務執行役員 金山 健司
常務執行役員 山峯 直利
常務執行役員 宮本 正巳
執行役員 小竹 繁
執行役員 川上 晴彦
執行役員 本間 靖之

株式の状況 (2025年3月31日現在)

発行可能株式総数 900,000,000株
発行済株式の総数 238,002,985株
株主数 57,438名

株主構成

(所有者別株式分布状況)



大株主 (2025年3月31日現在)

株主名	持株数(千株)	持株比率(%)
KKR HKE INVESTMENT L.P.	42,505	18.25
BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC	35,080	15.06
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001	17,673	7.59
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	16,331	7.01
KKR HKE Investment L.P. G.P. KKR HKE Investment Limited	12,187	5.23
Qatar Holding LLC	11,520	4.95
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	4,730	2.03
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234	3,168	1.36
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)	2,313	0.99
HSBC - FUND SERVICES CLIENTS A/C 500	1,942	0.83

(注) 1. 当社は、自己株式5,058千株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
2. 持株比率は、自己株式を除いて算出しております。
3. 持株数は千株未満、持株比率は小数点以下第3位を四捨五入して表示しております。

株主メモ

事業年度	4月1日~翌年3月31日
定時株主総会	毎年6月
株主確定基準日	3月31日
期末配当金受領株主確定日	3月31日
中間配当金受領株主確定日	9月30日
単元株式数	100株
特別口座の口座管理機関	三菱UFJ信託銀行株式会社

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
東京都府中市日鋼町1-1

同連絡先 電話: 0120-232-711 (通話料無料)
郵送先: 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

上場市場 東京証券取引所 プライム市場

公告方法 電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

公告掲載URL https://www.kokusai-electric.com/public_notice/

ウェブサイトのご案内



株式会社 KOKUSAI ELECTRIC

〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3丁目4番地 oak神田鍛冶町ビル5階

TEL: 03-5297-8530 (代表)

<https://www.kokusai-electric.com>

